

電子零組件與半導體製造計畫 (SPECS)

1. 背景：

- 1.1. 印度政府高度重視電子硬體製造，其為印度政府「印度製造」和「數位印度」政策下重要支柱之一。與電子製造業以及價值鏈不同階段的競爭經濟體相較之下，印度整體電子製造業表現現今仍有提升的空間（約 8.5%-11%）。
- 1.2. 過去幾年來，印度國內電子產品製造業大幅增長，正穩定地從半散裝料 (SKD) 組裝方式朝向全散裝料 (CKD) 組裝方式轉變。唯如此進展，印度國內增值仍持續偏低，僅在 10-30%之間，主要原因乃在地無電子零組件供應體系系統。此乃由於印度缺乏國家電子零組件製造生態系統、半導體製造生態系統和顯示器製造生態系統。印度電子製造業之主要增長係為滿足國內需求而組裝進口電子零組件成品。
- 1.3. 供應鏈發展是高附加值電子產品製造的關鍵。2019 年 2 月 25 日公佈的 2019 年國家電子政策 (NPE 2019) 願景是將印度定位為全球電子系統設計和製造 (ESDM) 的中心，藉由鼓勵和推動印度發展核心組件 (包括晶片組) 的能力，為該產業創造與全球競爭的有利環境。
- 1.4. 電子零組件和半導體製造實屬資本密集型，且須應對科技日新月異不斷變化。零組件乃電子產品之核心，是物料清單 (BOM) 總價值的重要組成部分。一個充滿活力的電子零組件製造生態系統對於印度電子製造業的整體長期和永續增長，以及實現國際收支平衡至關重要。
- 1.5. 吸引投資製造電子零組件和半導體的主要障礙包括「零關稅」進口，因為大多數電子零組件和半導體都在世界貿易組織 (WTO) 《資訊科技協定》 (ITA-1) 的範圍內；建立具有競爭力的全球規模能力需高資本成本；基礎設施不足；缺乏充足、可靠和高品質的電力以及具有競爭力的供水系統；缺乏供應鏈；物流成本高；缺乏科技等。
- 1.6. 修改後的特別獎勵計畫 (M-SIPS) 旨在提供財政獎勵，幫助抵消殘疾和高昂的前期成本，從而吸引電子製造業的投資。該計畫申請期限已於 2018 年 12 月 31 日截止，其為投資電子製造設備的資本支出提供補貼 (經濟特區單位占 20%，非經濟特區單位占 25%)。修改後的特別獎勵計畫在促進印度電子製造業投資方面發揮了重要作用。

2. 電子零組件與半導體製造計畫 (SPECS) :

2.1. 本計畫擬按電子產品供應鏈產品附件表，針對商品生產的資本支出提供 25% 財政獎勵。

3. 目標 :

3.1. 本計畫將有助於降低國內零組件和半導體製造方面的障礙，並強化印度電子製造業生態系統。

4. 資格 :

4.1. 本計畫適用於對新裝置的投資，以及擴大、升級現有裝置之產能/現代化/多樣化。

5. 門檻限制 :

5.1. 有關本計畫之最低投資門檻限制請參閱附件。

5.2 新廠房或擴建原廠房的門檻相同。

5.3 對於提供補助 (獎勵) 措施的貨品清單或門檻之變更 (如有)，將定期進行審查。

6. 計畫申請期限 :

6.1. 自公告日(即 2020 年 4 月 1 日)起 3 年內開放申請。本計畫將持續評估新申請案件，並按照本計畫所給予之核准繼續執行。

7. 計畫獎勵 :

7.1. 本計畫將對按附件表所列貨品投資廠房，給予資本性支出 25%的補助 (獎勵)。

7.2. 資本性支出係指建廠、機器、設備、相關生產器材及技術(R&D)；如翻新之廠房，其機器及設備(含器材及技術)，無論進口或當地購入，不能超過整廠資本投入之 20%，該項須列入補助計算中。

7.3. 倘有州政府或其他任何地方單位提供之獎勵補助高於本計畫之獎勵，則此獎勵應終止。

7.4. 本計畫之申請者仍有資格領取印度政府任何其他計畫之福利。申請人在 M-SIPS 計畫下承諾的投資，如已申請獎勵，則不符合本計畫之申請資格。

8. 核准和支付流程：

- 8.1. 任何在印度註冊的實體均可向本計畫提出申請。
- 8.2. 每一申請案都將被視為新投資，並將被視為一項獨立申請。申請只適用於單期工程，本計畫不考慮分期申請。申請人可同時申請多個或多次投資補助案。
- 8.3. 本計畫針對到期日前提交之完整初步申請，將持續評估並考慮核准。
- 8.4. 本計畫之獎勵將自申請確認之日起生效。確認書將在對申請進行初步審查後發出，申請之確認書不應解釋為本計畫之核准。
- 8.5. 本計畫之獎勵應於收到申請之日起 5 年內用於投資。
- 8.6. 符合本計畫申請資格的資本性支出補助（獎勵），經申請核准後發放，但資本性支出超過門檻並開始商業化生產者，其隨後的補助申請可每六個月提交一次。
- 8.7. 本計畫下獲補助之廠房必須保持至少 3 年之商業生產，從開始生產之日起計算，或從收到最後補助之日起一年，以較晚者為準。

9. 治理機制：

- 9.1. 本計畫將通過一個計畫執行機構執行並對申請進行評估。
- 9.2. 本計畫執行機構將作為專案管理機構（PMA），負責提供秘書、管理和執行協助，並執行印度電子資通訊部（MeitY）不時指派之其他職責。PMA 的功能和職責將在 MeitY 單獨發佈的《計畫指南》中詳細說明。
- 9.3. 為執行本計畫有關活動，專案管理機構（PMA）將特別：
 - 9.3.1. 接收申請，發出確認書，完成評估，並核實申請人是否符合本計畫的資助資格。
 - 9.3.2. 稽核報帳申請，並將補助發放給核准之申請人。
 - 9.3.3. 定期向印度電子資通訊部（MeitY）提交計畫進度和執行情況報告。
- 9.4. 專案管理機構將把經評估合格的申請提交給由印度電子資通訊部（MeitY）組成的執行委員會（EC）。執行委員會將由一名司長級官員（Joint Secretary）主持，並由其他部會/局處單位之代表組成，負責審核根據本計畫提出之申請。有關執行委員會的組成、職能和職責將於《計畫指南》中詳細闡述。

- 9.5. 執行委員會 (EC) 將建議專案管理機構 (PMA) 核准/拒絕/修改本計畫之申請案。PMA 應根據 EC 之建議，向本計畫申請者發出核准函，並將副本發送給印度電子資通訊部 (MeitY)。
- 9.6. 印度電子資通訊部 (MeitY) 須針對本計畫已獲批准之申請專案支付獎勵撥款，專案管理機構 (PMA) 將根據 MeitY 核准之條件及其財政規則進行獎勵之發放。PMA 須定期將預算要求作為合併金額提交予 MeitY，而非逐項提交。
- 9.7. 本計畫進展將透過治理委員會 (GC) 進行審查，GC 由印度電子資通訊部 (MeitY) 次長 (Secretary) 主持，並由來自政府代表和業界專家組成。GC 將定期審查本計畫及其專案的進展情況。GC 有權對《計畫指南》進行修訂，以成功執行計畫。有關 GC 的組織、職能和職責將在方《計畫指南》中詳細闡述。
- 9.8. 治理委員會應不時審查和修訂符合本計畫獎勵條件的貨品清單以及適用的門檻。
- 9.9. 為使本計畫有效運作，印度電子資通訊部 (MeitY) 應製定並發佈一套評估和支付指南。
- 9.10. 本計畫將進行期中評鑑，以評估既定目標之工業和經濟效益。

附件

符合電子零組件與半導體製造計畫 (SPECS) 獎勵資格之貨品清單

A. 最低投資門檻限制為 5000 萬盧比的貨品清單

序號	貨品描述
1.	SMT 電子零組件，含 LED 晶片
2.	智慧卡、射頻天線、CoB/系統封裝等晶片模組
3.	被動元件，含電阻、電容、鐵氧體等
4.	電子機構元件，含變壓器、感應器、線圈、繼電器、開關、微型馬達、步進馬達、直流無刷馬達、連接器、散熱器、天線、揚聲器、麥克風等
5.	磁控管、波導器、循環器、耦合器、隔離器、過濾器、磁鐵、設頻零件
6.	印刷電路板、PCB 基板、膠片、光聚合物膜片、印刷油墨；印刷及軟性電子
7.	感應器、傳感器、促動器及晶體
8.	相機模組、振動器
9.	USB 及 HDMI 傳輸線材
10.	涵蓋 SPECS 計畫之相關產品

B. 最低投資門檻限制為 15,000 萬盧比的貨品清單

序號	貨品描述
1.	主動元件： a. 離散半導體元件，包含晶體管、二極體等 b. 功率半導體，包含場效電晶體、金屬氧化物半導體場效電晶體、晶體閘流管
2.	二氧化矽及光纖初級加工品
3.	面板組裝及觸碰式螢幕

C. 最低投資門檻限制為 25,000 萬盧比的貨品清單

序號	貨品描述
1.	微型/奈米電子零組件
2.	組裝、測試、刻印、封裝(ATMP)等單元

D. 最低投資門檻限制為 75,000 萬盧比的貨品清單

序號	貨品描述
1.	塑件及金屬件機械設備

E. 最低投資門檻限制為 25 億盧比的貨品清單

序號	貨品描述
1.	化合物半導體，如 GaN、SiC、GaAs 等，矽光子元件、光電零組件

F. 最低投資門檻限制為 50 億盧比的貨品清單

序號	貨品描述
1.	半導體晶圓

G. 最低投資門檻限制為 100 億盧比的貨品清單

序號	貨品描述
1.	半導體積體電路(IC)，包含微處理器、微控制器、數位訊號處理器、特殊應用積體電路；記憶體、類比混合訊號積體電路
2.	面板製造，包含液晶面板、LED、OLED 等